

HOJA DE DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Solder Fortification®

Preformas de Soldadura

Introducción

Obtener la cantidad correcta de soldadura para asegurar una unión de soldadura fuerte es esencial en la fabricación de electrónicos. Sin embargo, las tendencias hacia la miniaturización, como la reducción del grosor del estencil, hacen esta tarea cada vez más difícil. Las **Preformas de soldadura (Solder Fortification®)** pueden brindar una solución a estos retos. Las **Preformas de soldadura (Solder Fortification®)** son generalmente piezas rectangulares o con forma de disco de aleación de metal que no contienen ningún tipo de flux. La preforma se añade a un depósito de soldadura en pasta, utilizando un equipo de colocación (pick and place). Puesto que la aleación tanto de la preforma como de la soldadura en pasta son iguales, la preforma se refluira a la misma temperatura que la soldadura en pasta, y ésta aportará el flux necesario. La preforma aumenta el volumen de la soldadura por encima de lo que se habría logrado con solo la pasta de soldadura, especialmente para estenciles con fine pitch de 0.3mm o menos.

Características

- Mayor volumen de soldadura
- Resultados de pruebas de caída (drop test) mejorados
- Menos problemas con el residuo del flux
- Menos retoques
- Forma y volumen de los filetes mejorado

Ventajas

Las ventajas de las **Preformas de soldadura (Solder Fortification®)** incluyen:

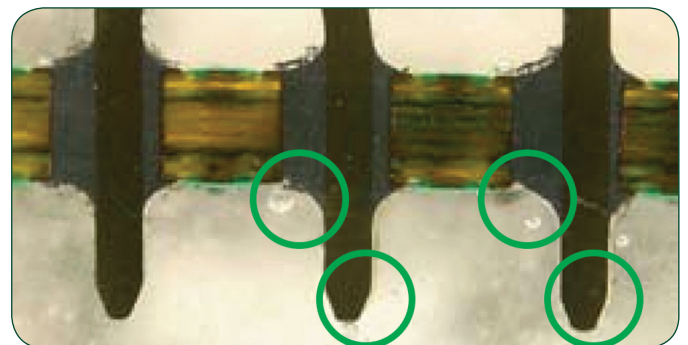
- Mayor volumen en la soldadura, en comparación con lo que se podría lograr solo con la soldadura en pasta
- Menos problemas con el residuo del flux
- Eliminación de procesos costosos o que quitan tiempo, como la soldadura de ola o la soldadura selectiva
- Uniones de soldadura más fuertes, que ayudan a mejorar los resultados de las pruebas de caída (drop test)
- Reducción de retoques y otros procesos manuales para agregar volumen de soldadura
- Mejora en la forma y volumen de las filetes para asegurar que las uniones de soldadura cumplen con las especificaciones del IPC

Empaque

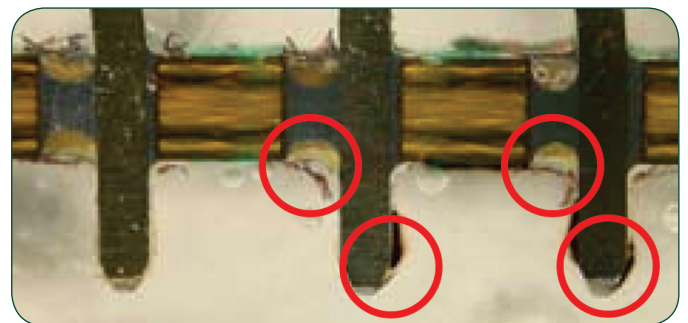
Preformas de soldadura (Solder Fortification®) están empacados en tape and reel para mayor facilidad en su colocación con las máquinas de colocación. Aleaciones Comunes.

- SAC305
- SAC387
- Sn63
- Sn62
- BiSn
- BiSnAg

From One Engineer To Another®



La preforma de soldadura + soldadura en pasta brindaron uniones de soldadura para through-hole excelentes.



Insuficiencia de soldadura en una union de soldadura procesada con PIP. Nótese también el exceso de residuo de flux.



Preformas de Soldadura Solder Fortification®

Opciones Más Populares de Solución de Solder Fortification®

Nombre	Tamaño	Cantidad por Carrete		Peso de Ejemplo SAC305 (gramos/cu)
		7"	13"	
0201	Rectángulo de 0.254mm x 0.508mm x 0.254mm (0.010" x 0.020" x 0.010")	1k	50k	0.00024
0402	Rectángulo de 0.508mm x 1.02mm x 0.508mm (0.020" x 0.040" x 0.020")	1k	15k	0.00182
0603	Rectángulo de 0.76mm x 1.52mm x 0.787mm (0.030" x 0.060" x 0.031")	1k	15k	0.00672
0805	Rectángulo de 1.27mm x 2.03mm x 1.27mm (0.050" x 0.080" x 0.050")	1k	15k	0.02410

Otras Soluciones Comunes de Solder Fortification®

Nombre	Tamaño	Cantidad por Carrete		Peso de Ejemplo SAC305 (gramos/cu)
		7"	13"	
½ 0402	Rectángulo de 0.508mm x 1.02mm x 0.254mm (0.020" x 0.040" x 0.010")	1k	15k	0.00091
½ 0603	Rectángulo de 0.76mm x 1.52mm x 0.38mm (0.030" x 0.060" x 0.015")	1k	15k	0.00336
½ 0805	Rectángulo de 1.27mm x 2.03mm x 0.635mm (0.050" x 0.080" x 0.025")	1k	15k	0.01205



Soporte Técnico

Los ingenieros de experiencia internacional de Indium Corporation brindan asistencia a profundidad a nuestros clientes. Los Ingenieros de Soporte Técnico tienen amplios conocimientos sobre todas las áreas de la Ciencia de Materiales aplicada a los sectores de la electrónica y los semiconductores, por lo que brindan consejos expertos sobre las propiedades de la soldadura, la compatibilidad de aleaciones y la selección de preformas de soldadura, así como soldadura en rollo, cintas y pasta. Los Ingenieros de Soporte Técnico de Indium Corporation le dan respuesta rápida a todas las consultas técnicas.

Hojas de Información de Seguridad

Puede encontrar las SDS para este producto en línea en <http://www.indium.com/sds>

Esta hoja de datos del producto se proporciona con fines informativos generales únicamente. Su finalidad no es garantizar ni asegurar —ni debe interpretarse en tal sentido— el desempeño de los productos descritos, que se venden sujetos exclusivamente a las limitaciones y las garantías escritas que constan en el envase del producto y las facturas. Todos los productos y soluciones de Indium Corporation están diseñados para venderse comercialmente, a menos que se indique lo contrario específicamente.

Todas las instalaciones de fabricación de pasta de soldadura y premoldeados de Indium Corporation tienen certificación de la IATF 16949:2016. Indium Corporation es una empresa registrada en la ISO 9001:2015

Contacte a nuestros ingenieros: askus@indium.com

Obtenga más información: www.indium.com

ASIA +65 6268 8678 • CHINA +86 (0) 512 628 34900 • EUROPA +44 (0) 1908 580400 • EE. UU. +1 315 853 4900



©2020 Indium Corporation